سیویلیکا – ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا
CIVILICA.com

عنوان مقاله:

رسوب لایه اتمی Atomic Layer Deposition

محل انتشار:

دومین همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر، برق و تکنولوژی (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

سیدمحمد علوی – دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

جلایر فرزام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

خلاصه مقاله:

رسوب گذاری لایه نازک به روش های مختلف انجام می گیرد که هر کدام از آنها کاربردهای مختلفی در صنعت دارد. در این مقاله به بررسی روشهای رسوب لایه اتمی ((ALD پرداخته شده است. همچنین ابزارهای مدلسازی و کاربردهای آنها را شرح میدهد. در ادامه ی این مطالعه، به بررس انواع و همچنین ویژگی ها، مزایا و کاربردهای روش رسوب لایه اتمی می پردازد.

کلمات کلیدی:

رسوب اتمی (ALD، PEALD، TERMAL – ALD)

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

https://civilica.com/doc/1939614